

2022年3月期 第2四半期（2021年7月～9月） 東京エレクトロン 決算説明会

2021年11月12日

内容：

- 第2四半期 連結決算の概要 取締役 専務執行役員 布川 好一
- 事業環境および業績予想 代表取締役社長・CEO 河合 利樹

将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスク、新型コロナウイルスの影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上及び費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

第2四半期 連結決算の概要

2021年11月12日

布川 好一

取締役 専務執行役員 Global Business Platform本部長



損益状況（半期）

新収益認識基準

(億円)

	FY2021		FY2022	(ご参考) 8月16日発表の FY2022 H1予想
	H1	H2	H1	
売上高	6,681	7,309	9,325	9,000
SPE	6,354	6,797	9,057	8,740
FPD	326	511	266	260
売上総利益 下段：売上総利益率	2,648 39.6%	3,001 41.1%	4,228 45.3%	4,000 44.4%
販管費	1,173	1,268	1,482	1,550
営業利益 下段：営業利益率	1,474 22.1%	1,732 23.7%	2,746 29.5%	2,450 27.2%
税金等調整前当期純利益	1,477	1,693	2,730	2,400
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,120	1,309	2,002	1,750
研究開発費	663	702	755	
設備投資額	282	256	251	
減価償却費	152	185	167	

1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上及び費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

損益状況（四半期）

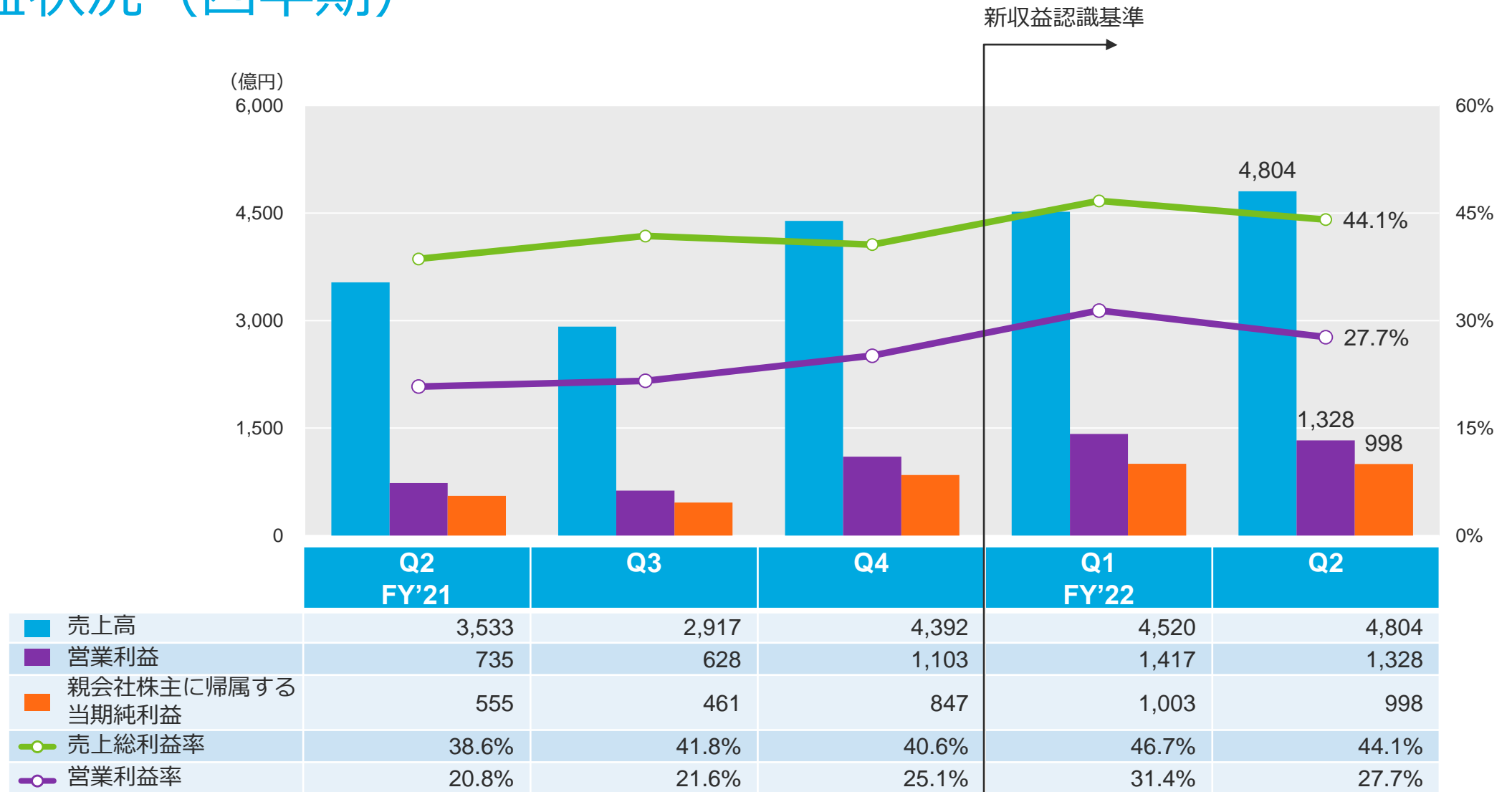
新収益認識基準

(億円)

	FY2021			FY2022		対FY2022 Q1 増減
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	
売上高	3,533	2,917	4,392	4,520	4,804	+6.3%
SPE	3,316	2,643	4,154	4,379	4,678	+6.8%
FPD	216	273	237	140	125	-10.6%
売上総利益	1,363	1,219	1,782	2,109	2,119	+0.5%
下段：売上総利益率	38.6%	41.8%	40.6%	46.7%	44.1%	-2.6pts
販管費	627	590	678	691	790	+14.4%
営業利益	735	628	1,103	1,417	1,328	-6.3%
下段：営業利益率	20.8%	21.6%	25.1%	31.4%	27.7%	-3.7pts
税金等調整前当期純利益	730	623	1,069	1,380	1,350	-2.2%
親会社株主に帰属する 当期純利益	555	461	847	1,003	998	-0.5%
研究開発費	362	330	371	343	411	+19.9%
設備投資額	149	88	168	106	145	+37.3%
減価償却費	81	88	97	79	88	+11.6%

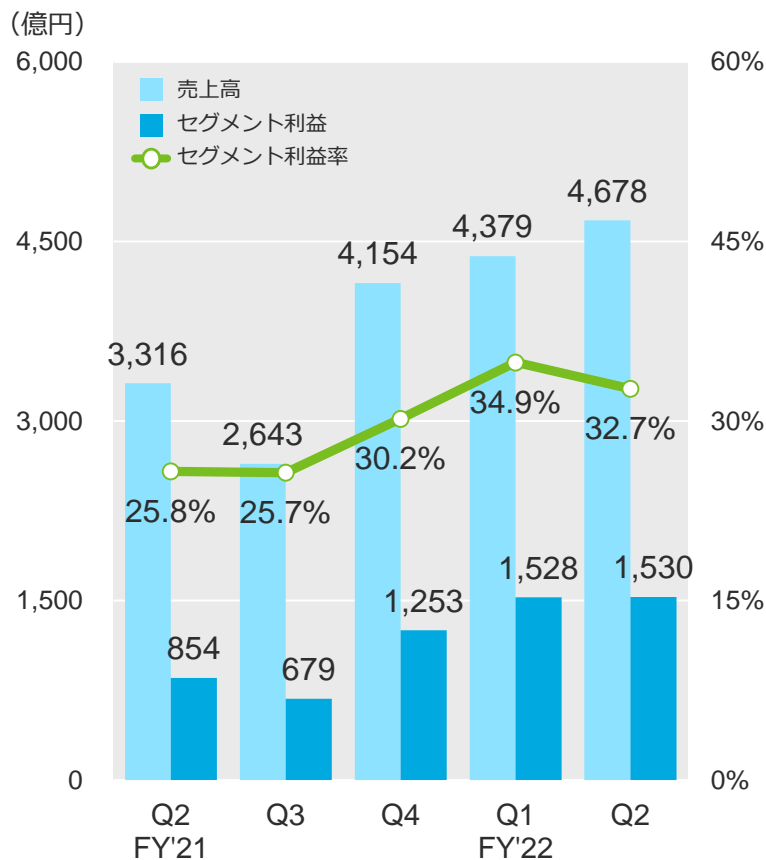
1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上及び費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

損益状況 (四半期)

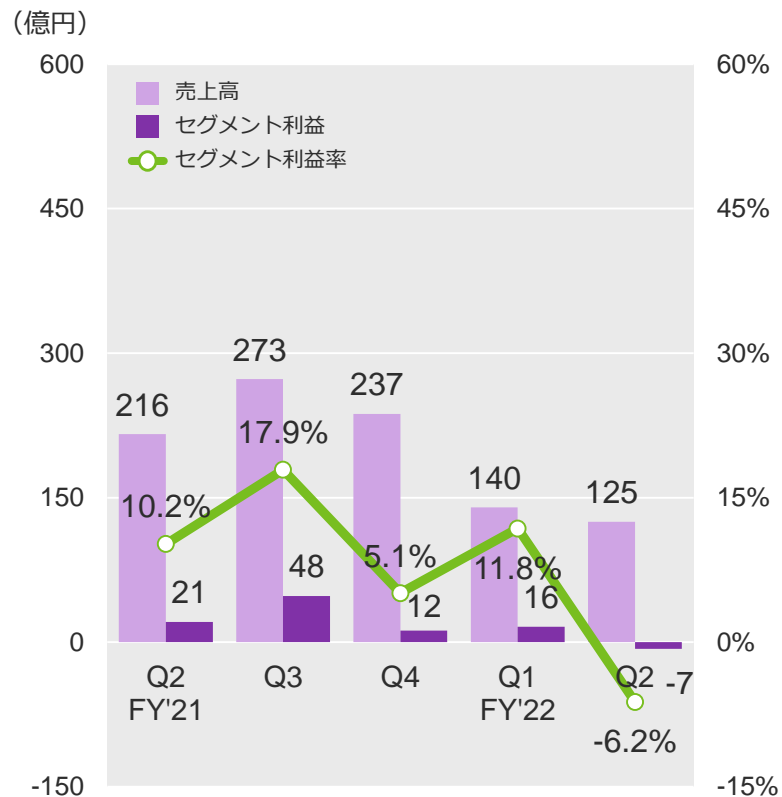


セグメント情報（四半期）

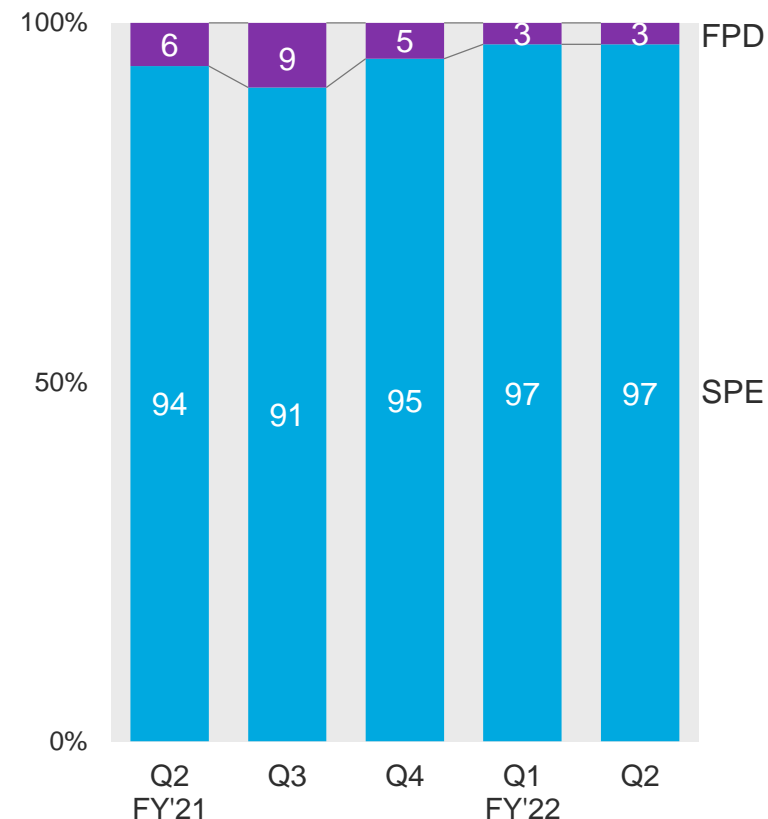
SPE（半導体製造装置）



FPD（フラットパネルディスプレイ製造装置）

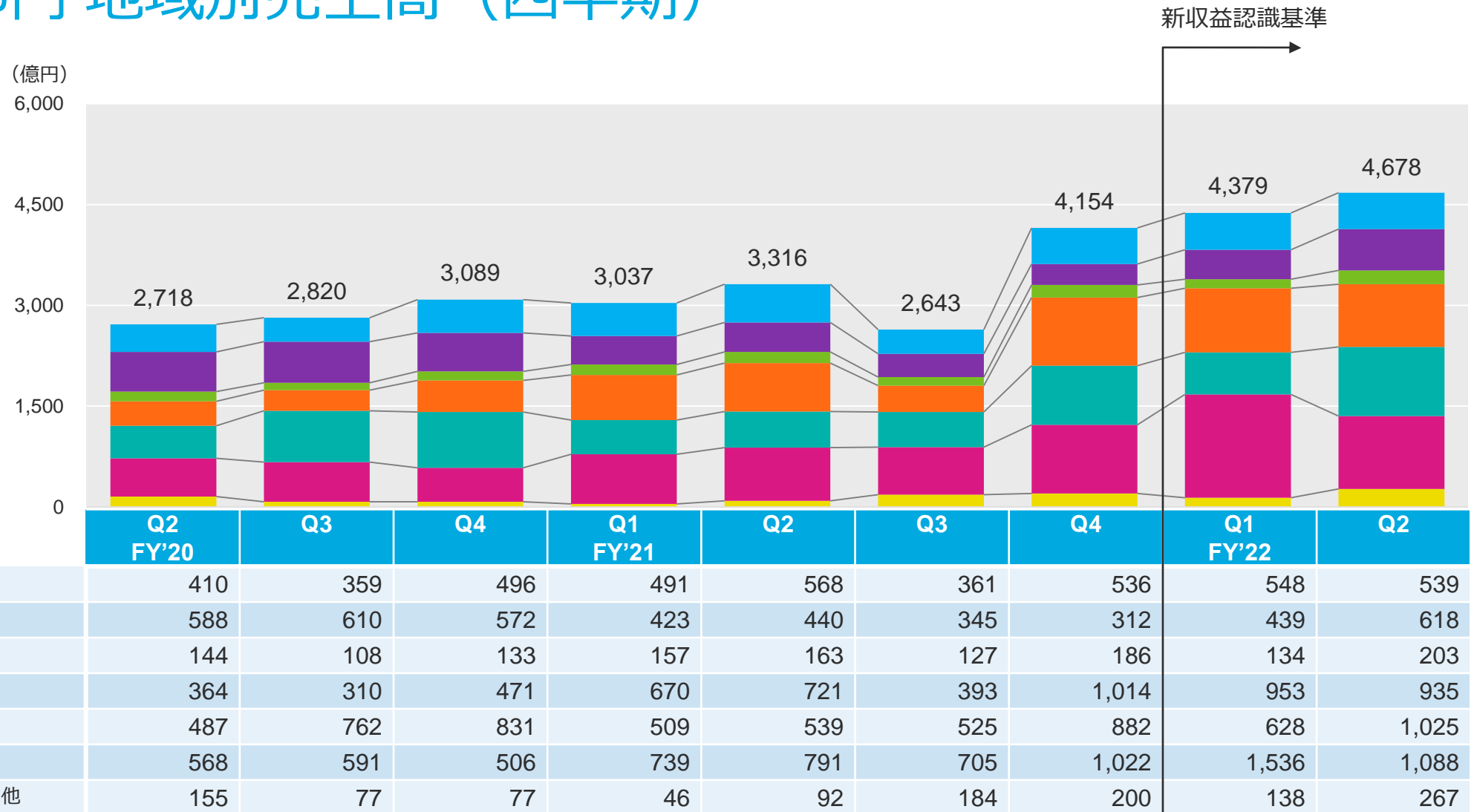


売上構成比率

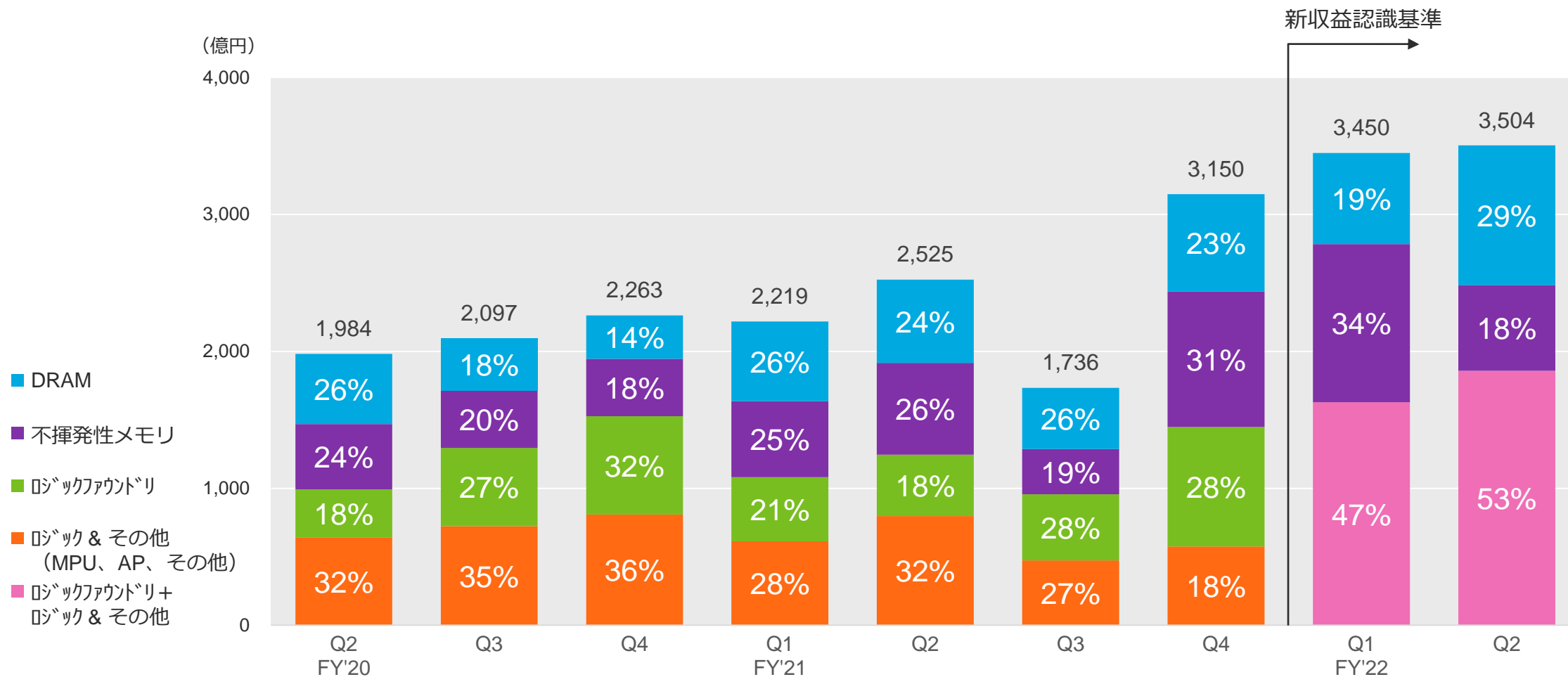


1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究又は要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

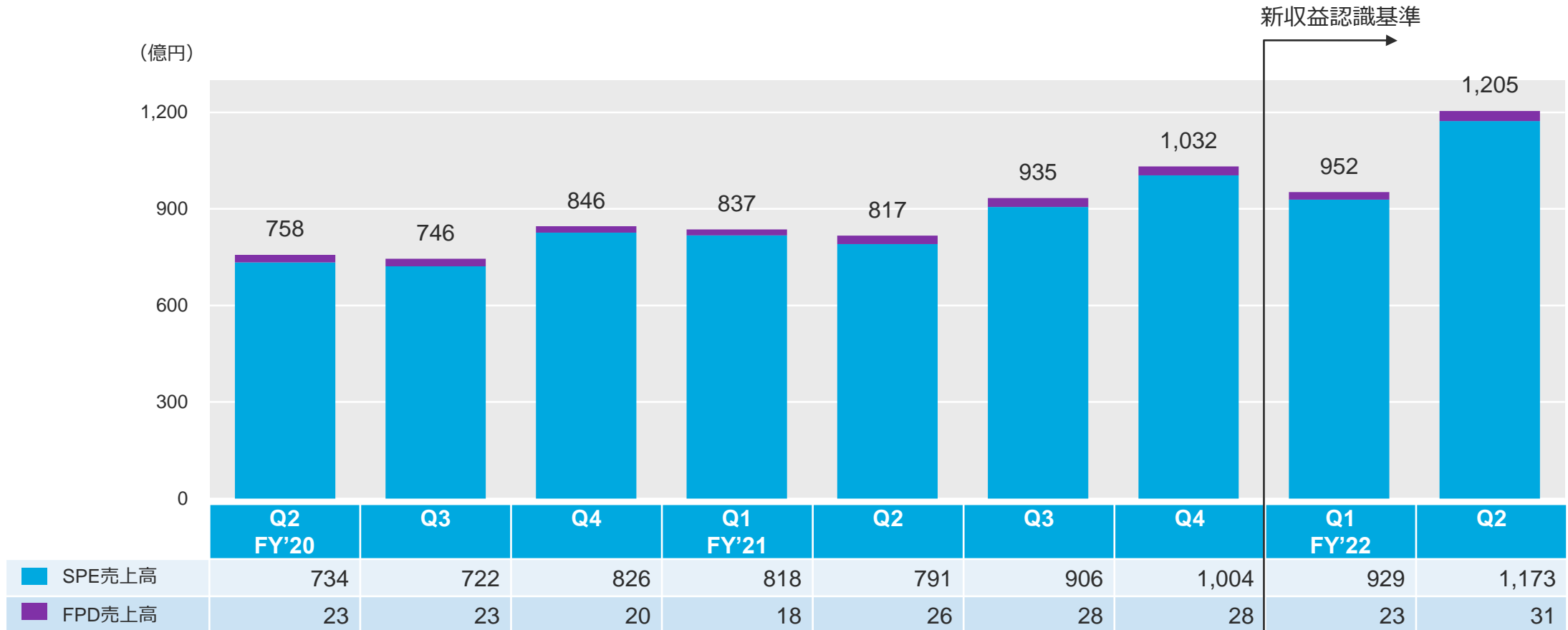
SPE部門 地域別売上高 (四半期)



SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）

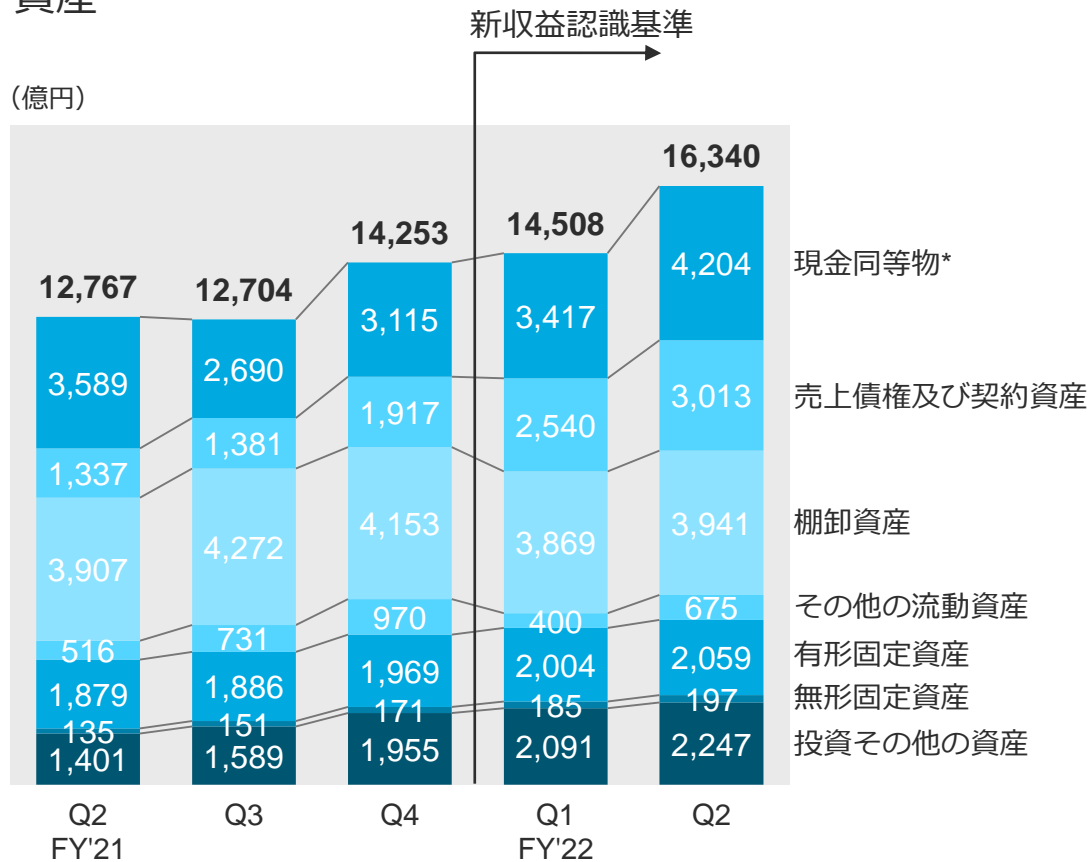


フィールドソリューション売上高（四半期）

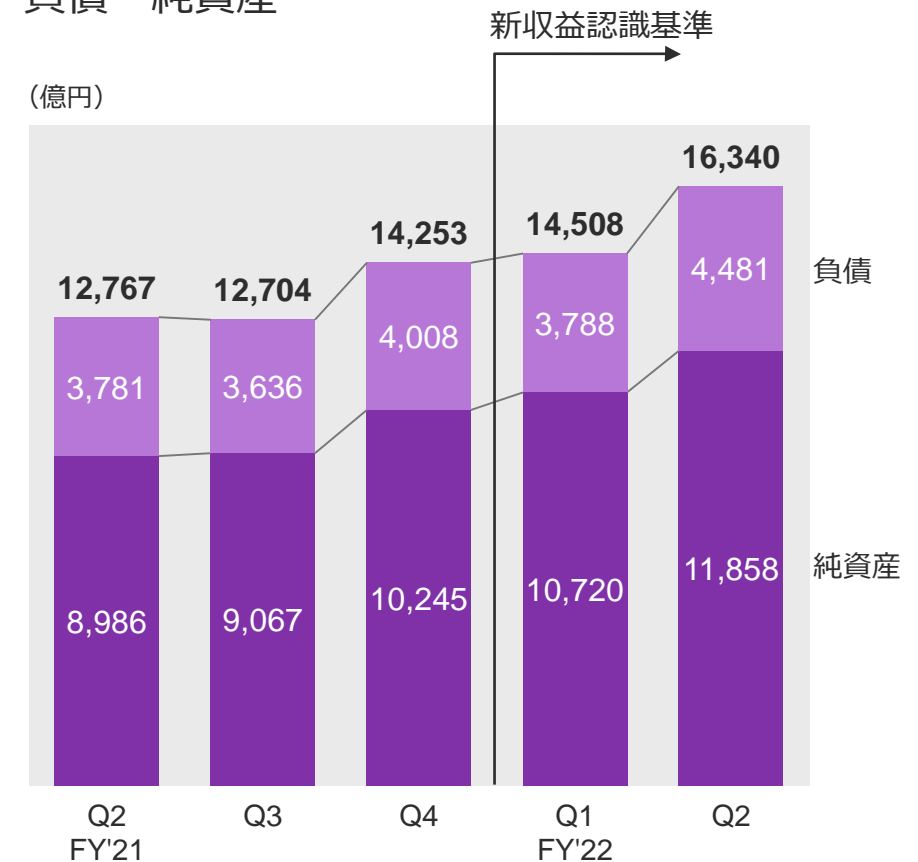


貸借対照表 (四半期)

資産

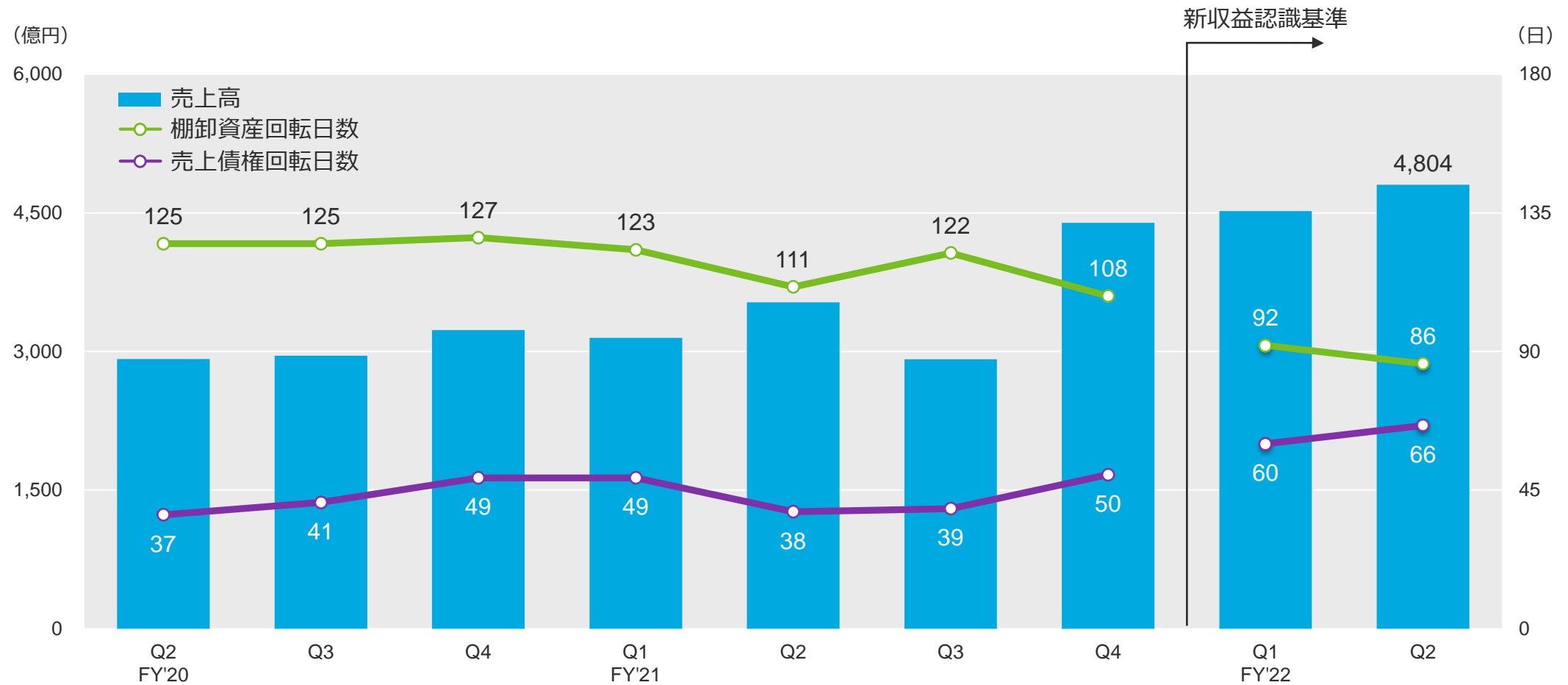


負債・純資産



* 現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

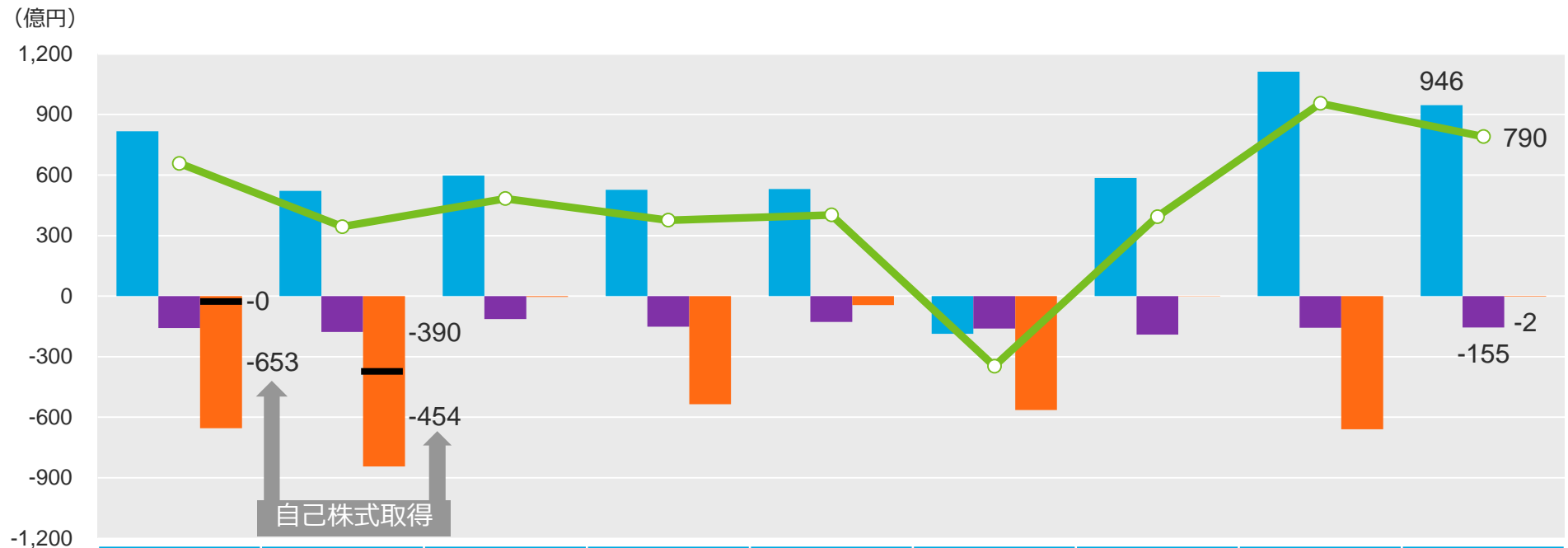
棚卸資産・売上債権の回転日数（四半期）



回転日数 = 売上債権もしくは棚卸資産 ÷ 各四半期末までの12カ月間売上高 × 365
 (売上債権には契約資産を含みます)

FY'22の回転日数については、収益認識基準は異なりますが、それぞれ当該四半期を含む過去4四半期の売上高に基づいて算出しています。

キャッシュ・フロー（四半期）



	Q2 FY'20	Q3	Q4	Q1 FY'21	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'22	Q2
営業キャッシュ・フロー	817	521	597	527	531	-186	586	1,112	946
投資キャッシュ・フロー*1	-158	-177	-114	-151	-128	-160	-191	-157	-155
財務キャッシュ・フロー	-654	-844	-4	-535	-44	-564	-1	-659	-2
フリーキャッシュ・フロー*2	658	344	483	376	402	-347	394	955	790
手元資金残高*3	3,399	2,922	3,384	3,226	3,589	2,690	3,115	3,417	4,204

*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

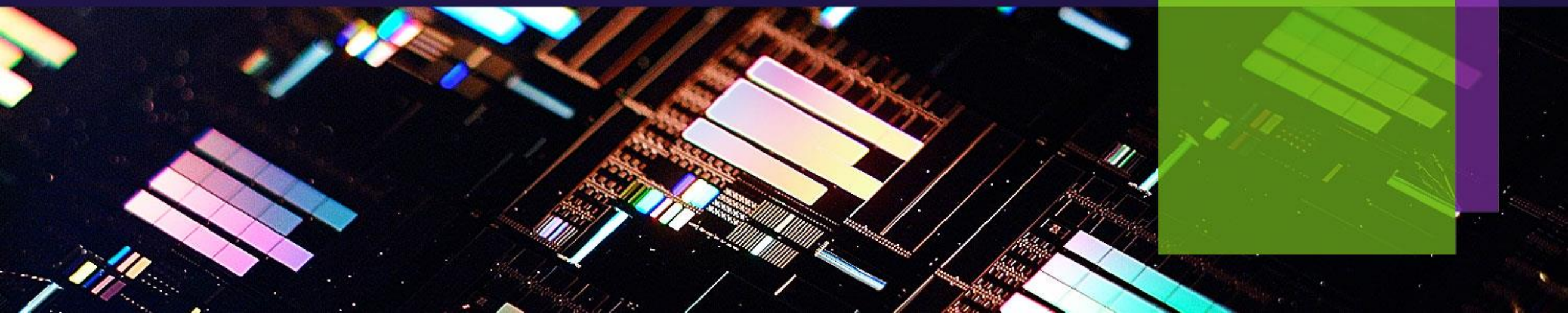
*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

事業環境および業績予想

2021年11月12日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



CY2021 事業環境（2021年11月時点での見方）

▶ 半導体前工程製造装置(WFE)*1の設備投資

データセンター投資のさらなる加速など、社会のデジタルシフトの進展による先端から成熟にかけて幅広い世代のロジックやメモリ需要の急増を背景に、WFE市場は大幅に拡大。
CY2021は前年比 5割に迫る成長の見通し

▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程*2向け設備投資

モバイル向けOLED投資は前年比で増加も、大型パネル向けLCD投資は一巡。今後、OLED投資に牽引され市場の成長が期待できるが、CY2021は大型パネル向け投資がLCDからOLEDに移行する端境期として前年比 2割程度減少の見通し

*1 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

*2 TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能をもつ基板を製造する工程

CY2021 アプリケーション別のWFE市場と事業機会

- ロジック/ファウンドリ：前年比 60%程度増加
 - 市場環境：情報通信技術の推進に伴うアプリケーションの拡大により、積極的な投資が一層進み、市場成長を牽引
 - 事業機会：難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大
- DRAM：前年比 60%程度増加
 - 市場環境：5Gモバイル、PC、データセンターの需要の増加により需給が逼迫。高水準の投資を見込む
 - 事業機会：微細化に向けた新たな技術、新たな材料への対応
- 不揮発性メモリ：前年比 20%程度増加
 - 市場環境：中長期のビット需要成長に向け、着実な投資が継続
 - 事業機会：高付加価値のエッチング・洗浄工程での差別化

FY2022 上期 事業進捗

- 売上高、利益ともに業績予想を超過
- 中期経営計画の達成に向け、順調に進捗
 - 注力製品の売上が計画どおり拡大
 - フィールドソリューションの売上高は半期で2,000億円を超える規模に
 - 将来に向けたPOR*獲得が進展
 - 高い生産性と先進機能を搭載したウェーハプロローバ Prexa™をリリース
- 宮城技術革新センター竣工。革新的な技術の創出と生産性向上を推進
- imec-ASML 共同high-NA EUV研究所と装置導入契約を締結
- 環境への取り組み強化に向けたサプライチェーンイニシアティブ「E-COMPASS」を立ち上げ

FY2022 業績予想

FY2022 業績予想

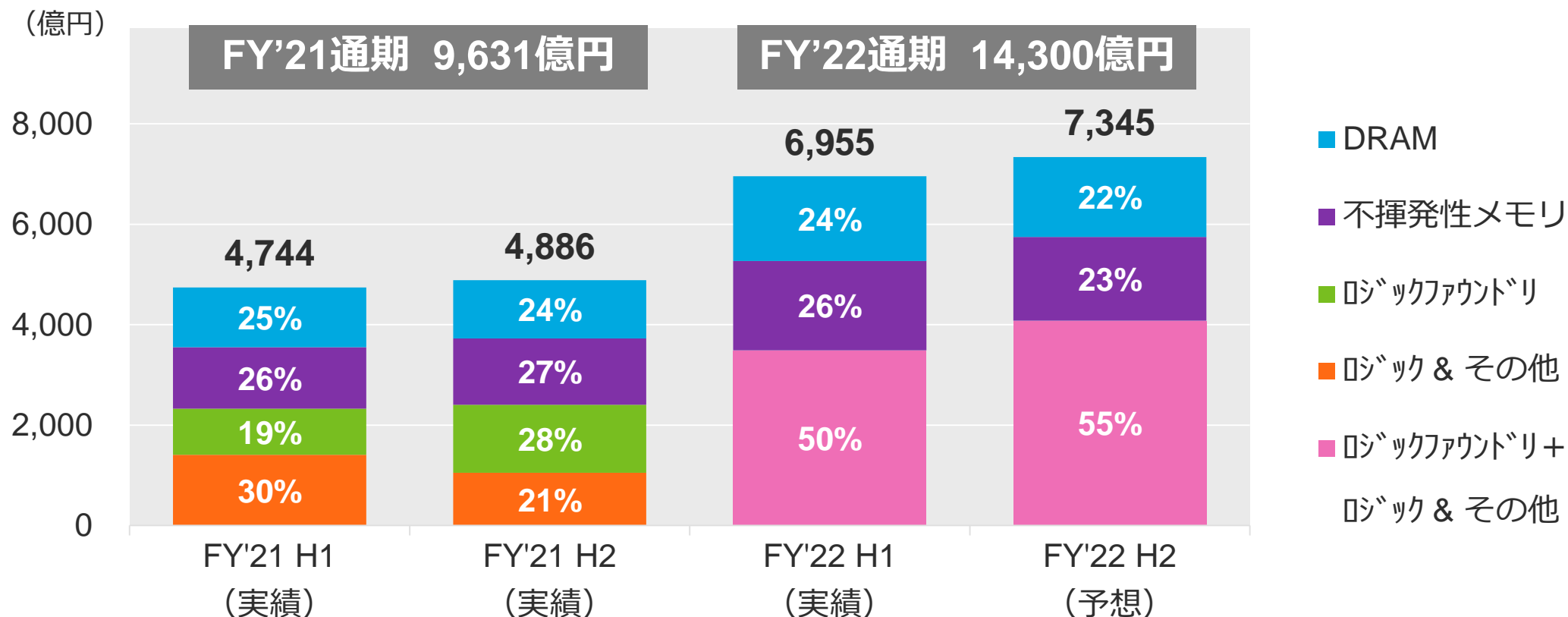
* 修正額：2021年8月16日に発表した業績予想からの修正額を示しています。（億円）

	FY2021	FY2022			
	実績	実績	新予想		修正額
	通期	H1	H2	通期	通期
売上高	13,991	9,325	9,675	19,000	+500
SPE	13,152	9,057	9,342	18,400	+470
FPD	837	266	333	600	+30
売上総利益 下段：売上総利益率	5,649 40.4%	4,228 45.3%	4,382 45.3%	8,610 45.3%	+370 +0.8pts
販管費	2,442	1,482	1,618	3,100	-60
営業利益 下段：営業利益率	3,206 22.9%	2,746 29.5%	2,764 28.6%	5,510 29.0%	+430 +1.5pts
税金等調整前当期純利益	3,170	2,730	2,730	5,460	+430
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,429	2,002	1,998	4,000	+300
1株当たり当期純利益 (円)	1,562.20	1,286.74	-	2,569.88	+191.35

さらなる事業機会を取り込み、通期業績予想を上方修正

FY2022 SPE部門 新規装置売上予想

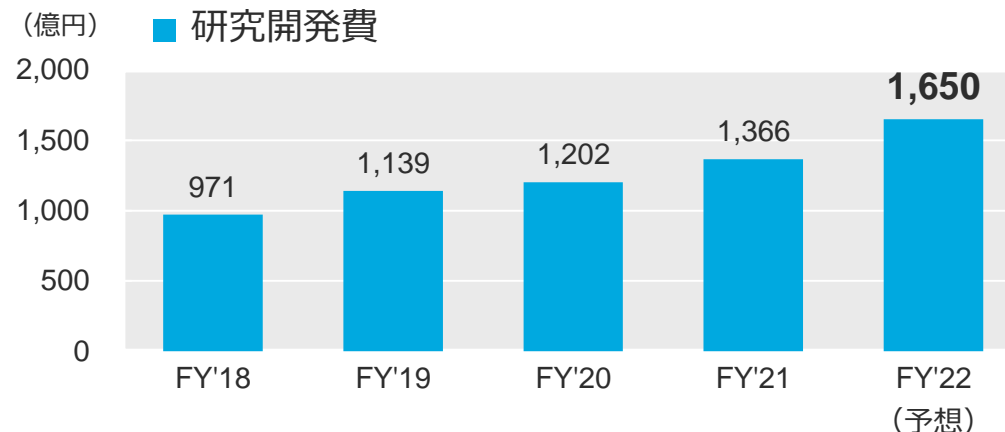
アプリケーション別売上構成比



過去最高であったFY2021を大幅に上回る見込み

FY2022 研究開発費・設備投資計画

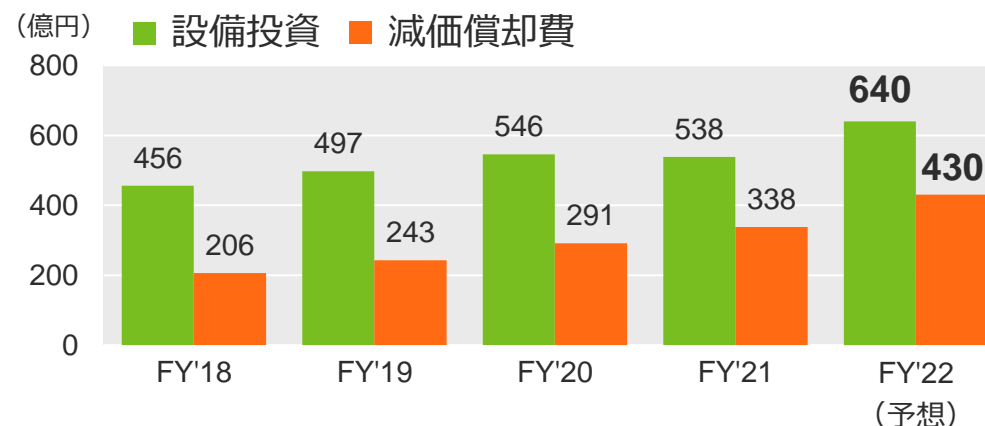
- 研究開発費 1,650億円
 - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 640億円
 - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 430億円



宮城県黒川郡：建設費約70億円
(2021年9月 竣工)



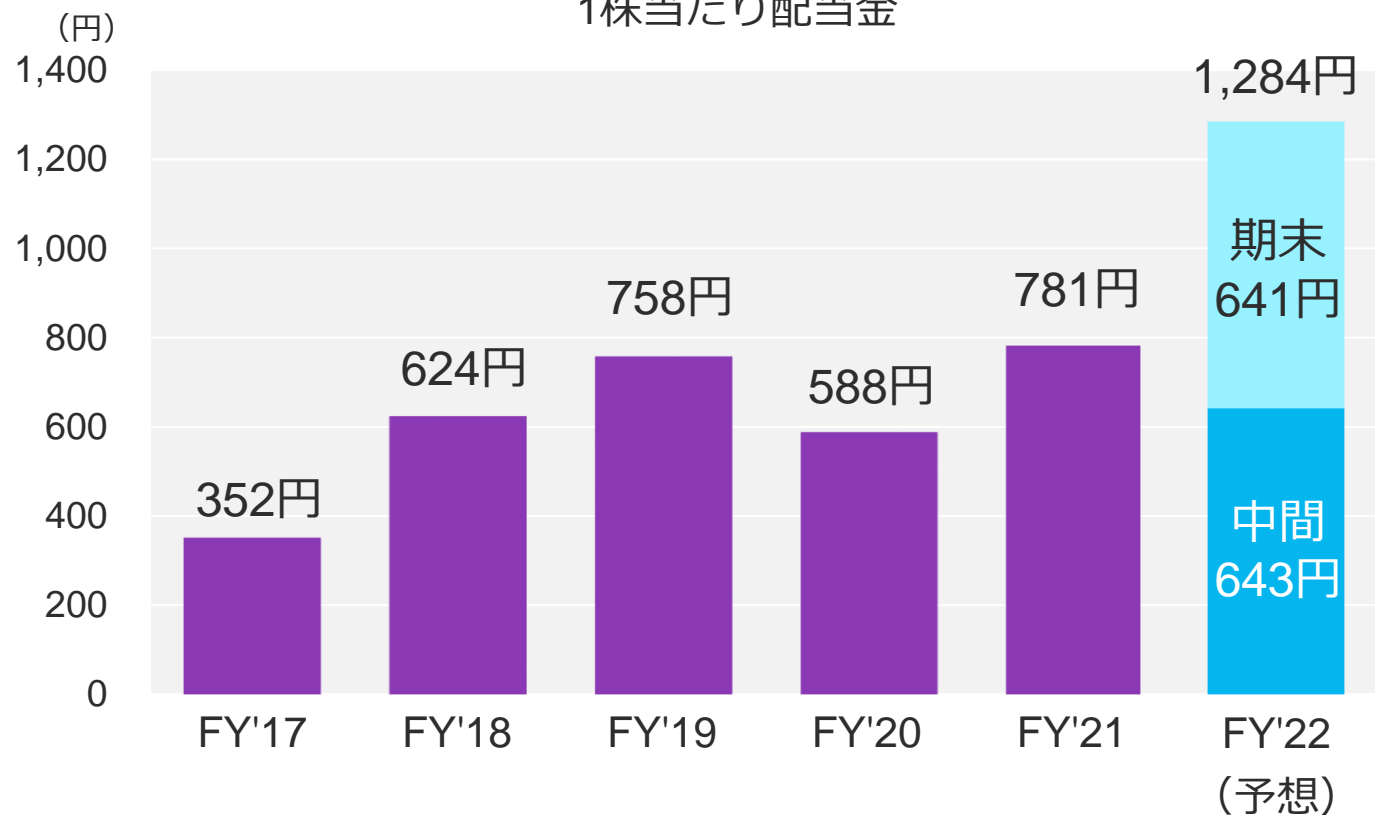
山梨県韮崎市：建設費約110億円
(2023年春 竣工予定)



拡大する市場と多様化する最新技術ニーズを見据え、
研究開発、設備投資を加速

FY2022 配当予想

1株当たり配当金



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

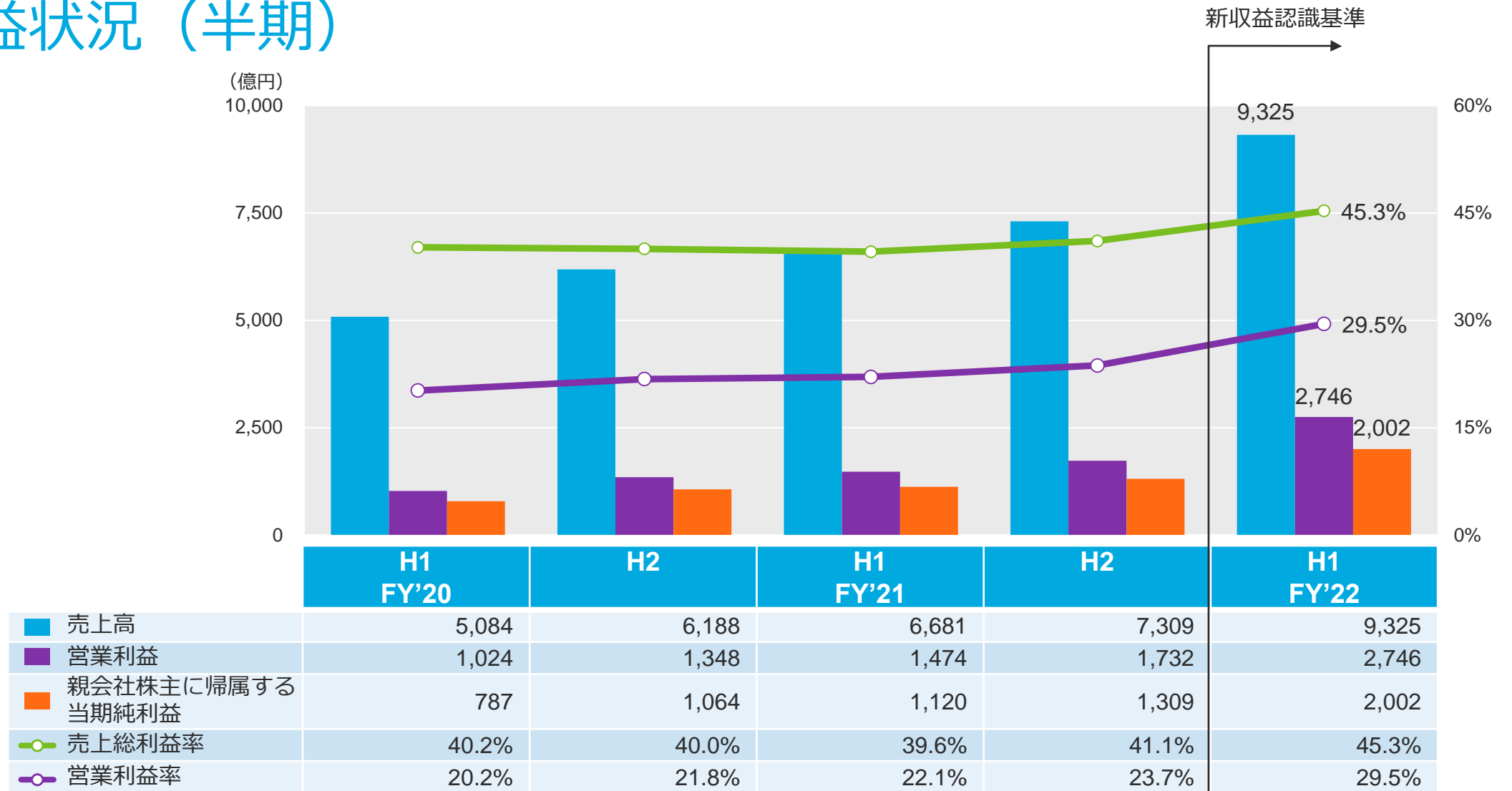
2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

業績予想上方修正に伴い、通期配当金は1,284円を予定

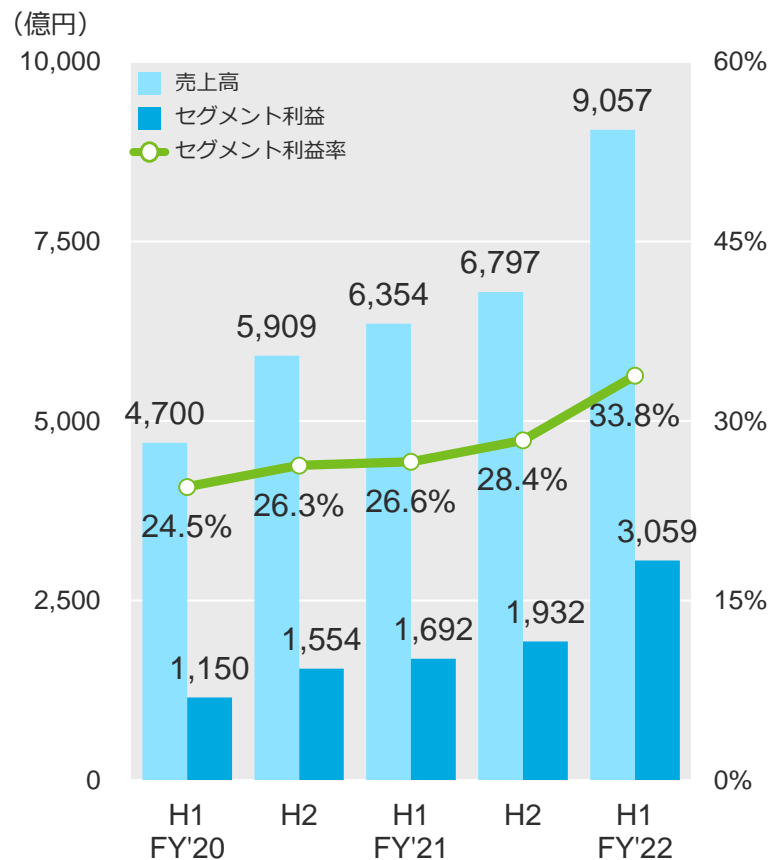
Appendix

損益状況 (半期)

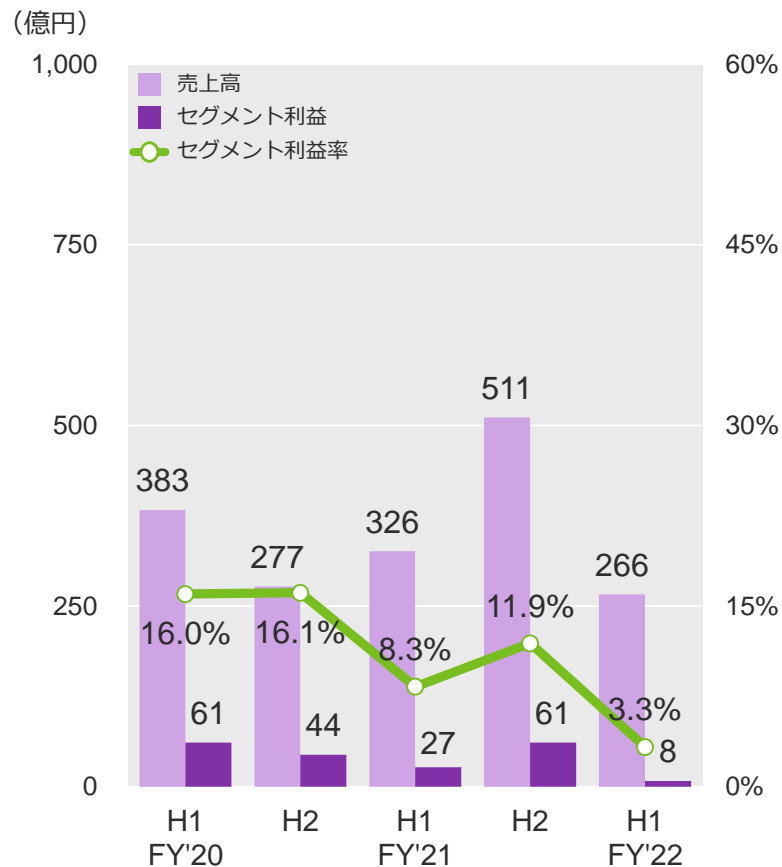


セグメント情報（半期）

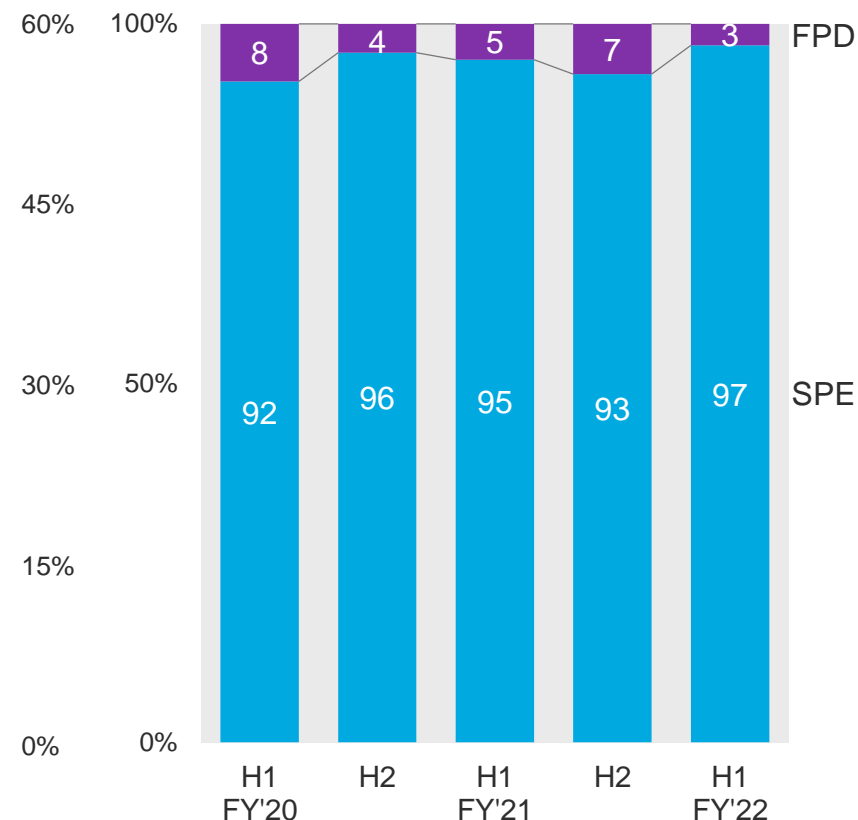
SPE（半導体製造装置）



FPD（フラットパネルディスプレイ製造装置）



売上構成比率



1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究又は要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

TEL™

TOKYO ELECTRON